

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年1月20日(20.01.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/013995 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/60 (2006.01)

Kohei); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2
丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/027600

(22) 国際出願日: 2020年7月16日(16.07.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川(SHINKAWA LTD.) [JP/
JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2
丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特
許事務所(YKI INTELLECTUAL PROPERTY
ATTORNEYS); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥
寺本町一丁目 3 4 番 1 2 号 Tokyo (JP).

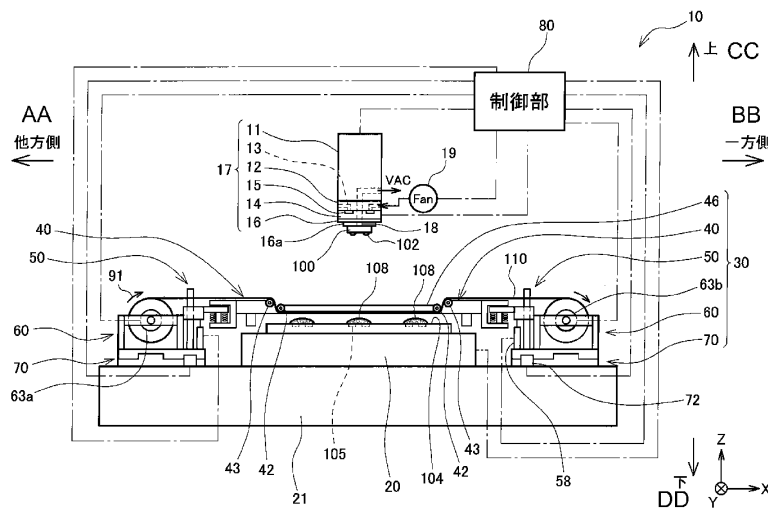
(72) 発明者: ジャンギーロブ アレクサンダー
(DZHANGIROV, Alexander); 〒2088585 東京都
武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式
会社新川内 Tokyo (JP). 瀬山 耕平(SEYAMA,

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: MOUNTING DEVICE

(54) 発明の名称: 実装装置

[図1]



19 Fan
80 Control unit
AA Other direction
BB One direction
CC Up
DD Down

(57) Abstract: The present invention comprises: a bonding stage (20) that holds a substrate (104) on which a semicon-
ductor chip (100) is disposed; a base (21); a mounting head (17) to which is attached a pressing tool (16) that presses
the semiconductor chip (100) against the substrate (104); and a film arrangement mechanism (30) that is provided on the
base (21), moves a cover film (110) along the bonding stage (20), and arranges the cover film (110) between the pressing
tool (16) and the semiconductor chip (100) pressed against the substrate (104). The film arrangement mechanism (30)
includes: a film guide (40) that guides the cover film (110) and regulates the height with respect to the bonding stage (20);
and a raising/lowering mechanism (50) that is connected to the film guide (40) via a spring (56), and raises and lowers

[続葉有]

WO 2022/013995 A1

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

the film guide (40) in relation to the bonding stage (20).

(57) 要約: 半導体チップ(100)が配置された基板(104)を保持するボンディングステージ(20)と、基台(21)と、半導体チップ(100)を基板(104)に押圧する押圧ツール(16)が取付けられた実装ヘッド(17)と、基台(21)に設けられ、カバーフィルム(110)をボンディングステージ(20)に沿って移動させて基板(104)に押圧される半導体チップ(100)と押圧ツール(16)との間にカバーフィルム(110)を配置するフィルム配置機構(30)と、を備え、フィルム配置機構(30)は、カバーフィルム(110)をガイドするとともにボンディングステージ(20)に対する高さを規定するフィルムガイド(40)と、スプリング(56)を介してフィルムガイド(40)に接続され、フィルムガイド(40)をボンディングステージ(20)に対して昇降させる昇降機構(50)と、を含む。